

正本

裝

訂

線

經濟部智慧財產局專利核駁審定書

受文者：日本電氣股份有限公司（代理人：周良謀先生）

地址：新竹市東大路一段一一八號十樓

發文日期：中華民國九十年十二月三日
發文字號：（九〇）智專二（一）04048字

第〇九〇八三〇二一一八四號

一、申請案號數：〇八九一二四一二六

二、發明名稱：半導體裝置及其製造方法

三、申請人：

名稱：日本電氣股份有限公司

地址：日本

四、專利代理人：

姓名：周良謀先生

地址：新竹市東大路一段一一八號十樓

五、申請日期：八十九年十一月十四日

六、優先權項目：

1 1999/11/16 日本11-325770

專利分類第七版：H01L 23/12

90.12.-5
90121030

七、審查委員姓名：王榮華 委員

八、審定內容：

主文：本案應不予專利。

依據：專利法第二十條第二項。

理由：

(一) 本案之技術特徵有二：(1) 利用絕緣緩衝樹脂包覆導電凸塊以減低應力；(2) 絕緣應力緩衝樹脂層可形成於半導體基板表面，使半導體晶片製造步驟以晶圓為單位得以實現。

(二) 惟利用特徵(1)以減低應力，實屬習知技術（如一九九九年一月二十二日公告之「017044」，其亦係利用絕緣緩衝樹脂包覆導電凸塊以減低應力）。至於製造步驟以晶圓為單位，而從一個晶圓的分割獲得大量的半導體晶片之技術特徵，則已揭示於一九九九年二月二日公告之美國專利第5868949號（附件二）。因此，本案所有關鍵技術特徵均可直接參考引證案而得之，本案所請係結合引證案技術，而為熟知此技藝者可輕易完成，其產生功效，亦囿於可預期之範圍，本案不具進步性。

據上論結，本案不符法定專利要件，爰依專利法第二十條第二項，審定如主文。

如不服本審定，得於文到之次日起三十日內，備具再審查理由書一式二份及規費新台幣參仟伍百元整，向本局申請再審查。

裝

訂

線

局長
陳明邦

依照分層負責規定
授權單位主管決行